

第9回日本複合材料会議(JCCM-9)

講演募集



期日：平成30年2月28日(水)～3月2日(金)

主催 日本材料学会，日本複合材料学会

協賛 (予定)

日本機械学会，日本航空宇宙学会，複合材料界面科学研究会，強化プラスチック協会，先端材料技術協会，高分子学会，日本金属学会，日本接着学会，日本繊維機械学会，応用物理学会，日本原子力学会，日本高圧力技術協会，日本コンクリート工学会，日本セラミックス協会，日本包装学会，日本溶接協会，腐食防食学会，関西 FRP フォーラム，化学工学会，軽金属学会，自動車技術会，精密工学会，セメント協会，繊維学会，炭素材料学会，電気学会，土木学会，日本化学会，日本建築学会，日本ゴム協会，日本材料学会，日本材料強度学会，日本生体医工学会，日本船舶海洋工学会，日本塑性加工学会，日本鉄鋼協会，日本電子材料技術協会，日本バイオマテリアル学会，日本非破壊検査協会，日本木材学会，日本レオロジー学会，表面技術協会，プラスチック成形加工学会，溶接学会，素形材センター，日本プラスチック工業連盟，近畿化学協会，ほくりく ACM 研究会，フィラー研究会，プラスチック技術協会

趣旨 日本複合材料会議 (JCCM) は、『日本を代表する複合材料に関する会議』の設立を目的に，材料・構造の複合化と機能化に関するシンポジウム「JCOM」を発展，継承させる形で発足しました。平成22年3月の京都での開催を第1回とし，今回はその第9回目の開催にあたります。また母体となる日本材料学会，日本複合材料学会のシンポジウムとしては，それぞれ JCOM-47，JSCM-2018 にあたる歴史あるシンポジウムです。これまでもご好評をいただいております企業展示・技術展示につきましても，より一層の充実を図り，産学官の枠を超えた交流促進を進めます。材料や構造の機能化，知能化，複合化などに関する幅広いテーマについて，最新情報の交換，研究者間の交流，新分野の開拓を目的として，多数の皆様のご発表・ご参加をお待ちしております。

開催期日 平成30年2月28日(水)～3月2日(金)

会場 同志社大学 京田辺キャンパス 恵道館
〒610-0394 京田辺市多々羅都谷 1-3

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/kyotanabe.html>

講演募集分野 材料および構造の機能化・知能化・複合化に関連する分野(グリーンコンポジット，ナノコンポジット，バイオマテリアル，自動車用コンポジット，マテリアルデザイン(設計解析技術)，成形・加工，スマートコンポジット・非破壊検査，耐久性・環境劣化，界面・接合，力学特性，衝撃，数値解析，リサイクル，熱・電気特性，テキスタイルコンポジット，耐熱複合材料(MMC，CMC，耐熱樹脂など)，航空宇宙用途，医療用途，分子シミュレーション，3Dプリンティング等)

講演種別 日本語または英語による口頭発表(20分)のみ(ポ

スター発表は行われません)。なお発表登壇についてはお1人1件に限ります。

講演申込締切 平成29年11月6日(月)

講演申込方法 日本材料学会ホームページ内の申込サイトより，講演題目，著者名・登壇者名，所属名称，連絡先，優秀講演賞への応募有無，講演概要，キーワード等を入力してください。

※発表の採否，プログラムの編成については，JCCM-9 実行委員会にご一任下さい。

※参加申込みの際にお届けいただいた個人情報は，諸連絡，行事案内等の日本材料学会および日本複合材料学会の事業運営にのみ使用させていただきます。

優秀講演賞 登壇者が主催学会の学生会員であるもの(要申請)について，厳正な審査の上，優秀講演賞の授賞を行います。

講演論文締切 優秀講演賞に応募する場合：

平成29年11月20日(月) 必着

優秀講演賞に応募しない場合：

平成30年1月5日(金) 必着

講演論文 A4サイズ，4枚以内，日本語または英語。

詳細な執筆要領については，日本材料学会の複合材料部門委員会のホームページ(<http://compo.jsms.jp/>)をご参照下さい。

講演論文集 講演論文集については，学会ホームページからダウンロードする形で提供予定です。講演会場へPCをご持参頂くようお願いいたします。なお，当日会場にはインターネットに接続出来る環境を特段には用意致しません。講演論文集のデータを入れました貸し出し用のUSBメモリおよびCD-ROMをいくつか用意致します。それらをご利用頂くか，あるいはインターネットへのモバイル接続装置をお持ちの方は出来るだけそれらを持参のうえご利用下さいませようお願いします。詳細は学会ホームページをご覧ください。製本された講演論文集は発行致しませんのでご了承下さい。

参加登録料

主催および協賛学会等会員(一般)	6,000円
非会員(一般)	12,000円
主催および協賛学会等会員(学生)	3,000円
非会員(学生)	6,000円

*当日受付にて参加登録をお願い致します。

*上記登録料には，懇親会費は含まれておりません。

*協賛団体会員の方は，受付時に協賛団体および団体内における会員番号を登録用紙に記載頂きます様お願い致します。

企業展示

前回(JCCM-8)に引き続き，企業展示とプログラムリーフレットへの広告掲載を募集します。詳細についてはホームページにてお知らせ致します。

懇親会

平成30年3月1日(木) 夕刻(予定)

後日，学会ホームページにてご案内します。

参加費(予定)：5,000円(一般)，3,000円(学生)

問合せ先

日本材料学会・事務局

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町 1-101

Tel: 075-761-5321, Fax: 075-761-5325,

E-mail: jimu@jsms.jp

学会ホームページ <http://www.jsms.jp/>